

innodisk

# 宜鼎國際 (代號:5289) 業績說明會

董事長 簡川勝 2026.3.30

## 免責說明

本簡報及同時發佈之財務業務訊息及預測性資訊，乃是建立在本公司從內部及外部來源所取得之資訊基礎。本公司未來實際所發生之營運結果及財務狀況可能與這些明示或暗示之預測性資訊有所差異，其原因可能來自於本公司無法掌握之各種風險因素。

本簡報中對未來的展望反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任何變動或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 議程

- 公司簡介與概況
- 市場趨勢與產品策略
- 全球 AI IN ACTION 商務拓展
- ESG 永續承諾
- 財務資訊
- 提問與說明

# 公司簡介與概況

# 公司概況

營業額

**NT\$143億元**

(2025)

資本額

**NT\$9.6億**

EPS

**NT\$21.72**

(2025)

專利數

**203(+8)**

客戶數

**4,000+**

## 全球營運佈局



營業地區

25

全球員工

1,164

台灣：1,019 / 海外：145

基地面積  
(平方米)

27,000

建築面積：一廠  
(平方米)

12,000

建築面積：二廠  
(平方米)

15,000

Edge AI 系統與解決方案  
Edge AI 嵌入式周邊模組  
Edge AI 嵌入式相機模組

2026 產能  
(SMT x 6)

1,080K

最大產能  
(SMT x 8)

1,440K



宜蘭研發製造中心

## 廠辦空間

合計 5,900 坪

17F 500 坪 (安提)

16F 1,000 坪 (研發中心與運動交誼中心)



7F 1,000 坪 (安提 200 坪)

5F 1,000 坪

5F 1,000 坪

5F 1,000 坪

2F 400 坪 (安提 200 坪)



汐止  
全球營運總部

產能

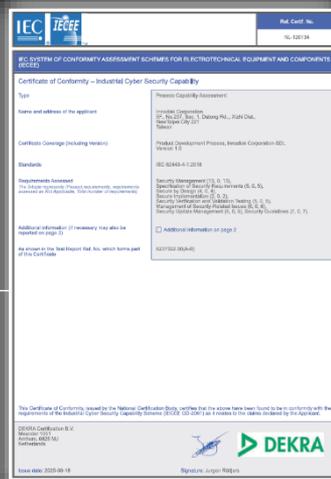
1,440K / 最大產能 (SMT x 8)

認證

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 /  
QC080000 / ISO14064-1 /  
ISO27001 / **IEC62443-4-1**

廠區

新北市 / 宜蘭縣



核心生產製造理念：品質、永續

## 全球夥伴與市場認可

### 合作夥伴



Intel 官方合作夥伴  
Gold Partner



NVIDIA Elite Partner (安提)  
MGX Partner (安提)



Qualcomm IoT  
官方合作夥伴



Azure Sphere  
官方合作夥伴



AI ASIC & NPU  
合作夥伴

### 經營成果

## Gartner

全球工業級固態硬碟  
市佔第一

## TRENDFORCE

全球前十大  
DRAM 模組供應商

## Interbrand

台灣國際品牌  
TOP 40

## Forbes

前 200 大  
亞洲中小型企業

### 產品創新



2026 E3.L PCIe Gen5 資料中心固態硬碟  
2026 LPDDR5X LPCAMM2 記憶體模組  
2026 MIPI over Type-C 8MP 定焦相機模組  
2026 邊緣 AI 系統 (APEX-P200)  
2026 AI 代理人邊緣運算工作站 (AIP-FR68S)  
2026 多加速卡邊緣 AI 推論系統 (AIP-MURE)



2026 高速網路擴充卡  
2025 MIPI over Type-C 相機模組  
2025 E3.L 5QS-P 資料中心固態硬碟  
2024 E1.S 4TG2-P 固態硬碟  
2023 nanoSSD 微型固態硬碟



2025 CXL 記憶體模組  
2022 極寬溫 DDR4 記憶體模組



2024 USB 嵌入式相機模組

# 市場趨勢與產品策略

## 雲端與網路通訊

1G to 5G → 雲端 & AI

頻寬成長 / 超低延遲與 AI 基礎建設 / 雲端服務與 AI 訓練

## Edge Computing & Device

PLC → IPC → IIoT → AIoT

自動化 / 工業應用 / 垂直市場 / 智慧互聯

Large Language Model

# Edge AI

-Privacy  
-Latency  
-Bandwidth

Open Sources SLM  
Neural Network: CNN,RNN

## 產業型 邊緣 AI

- 專注於萬物互聯
- 強固與耐用
- 即時與全天候運行



## 企業型 邊緣 AI

- 專注於 IT 架構
- 流程優化與可擴展性
- 資訊安全與隱私



# 雲端與邊緣 AI 雙重革命

## 應用升級 全面推進邊緣 AI 應用市場

### AI 基礎建設

- GPU 伺服器 / 網路交換器 / 路由器
- 人形機器人 / 無人機 / 無人自動化



### 全球 垂直應用領導品牌

- 醫療保健 / 5G / 安防監控 / 媒體娛樂 / 自動化
- Tier-1 市場領導品牌



### 高附加價值 工控解決方案供應商

- 製造產業 / 零售物流 / 智慧能源 / 醫療保健 / 網路通訊 / 航空航太 / 媒體娛樂 / 企業級應用
- 高附加價值及客製化服務
- 長期供貨與技術支持



## EDGE AI STACK: ARCHITECT INTELLIGENT

### 邊緣運算技術堆疊

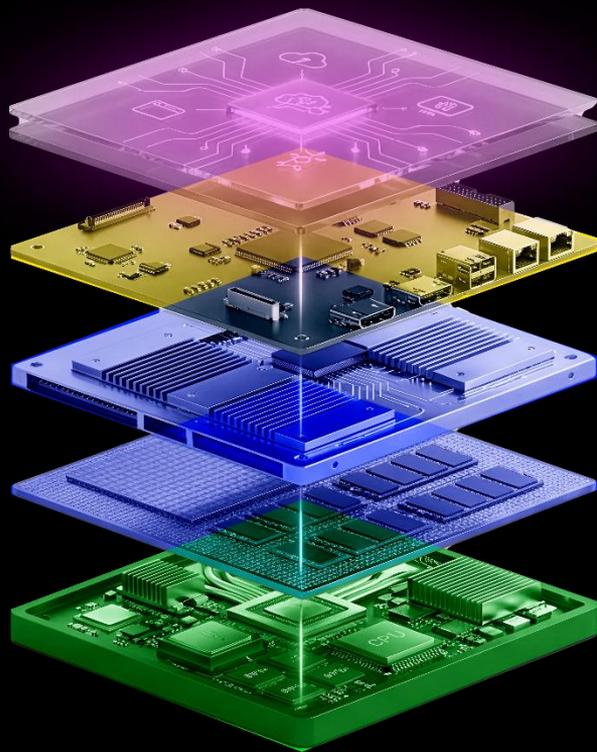
Stack 5: 軟體層 (Software)

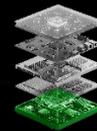
Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

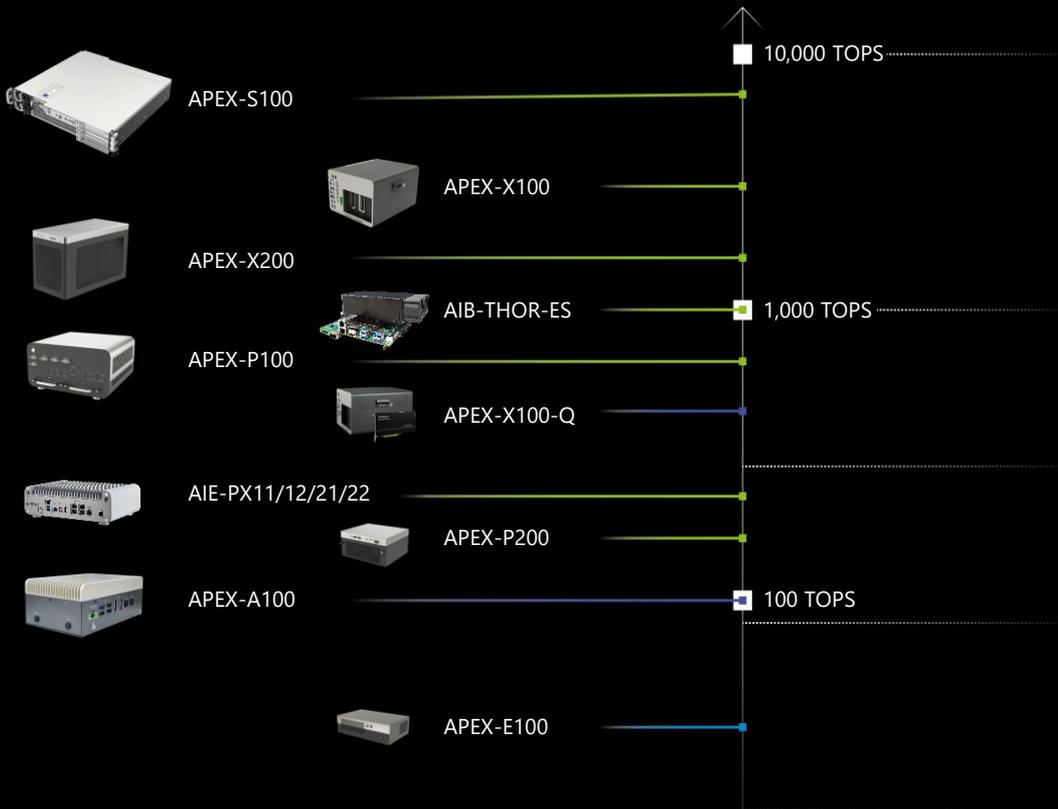
Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)

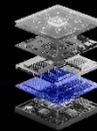




- NVIDIA
- Qualcomm
- Intel
- AI ASIC



(TOPS @ INT8)



## EMPOWERING EDGE AI COMPUTING

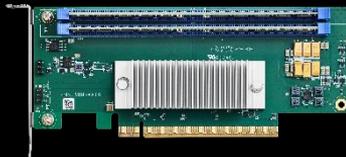
## DDR5 7200MT/s 邊緣 AI 超高速運算引擎



- 目標市場：邊緣 AI 和高速網通頻寬需求
- 效能展現：超低延遲和卓越的穩定性
- 應用領域：即時邊緣推理和海量資料處理

## BREAKING AI ARCHITECTURE BOTTLENECKS

## CXL AIC (ADD-IN-CARD) 打破邊緣運算的記憶體牆瓶頸



- 目標市場：突破次世代 AI 的「記憶體牆」瓶頸
- 關鍵特點：無縫、大規模記憶體擴充。
- 技術優勢：優化超大規模資料中心和 AI 訓練的整體擁有成本

## DRAM Module Portfolio

## AI Memory



## Embedded Memory



## Server Memory



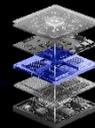
## Wide Temp. Memory



## Customized Memory



- 規格尺寸：  
CAMM2 / CUDIMM / CSODIMM / SODIMM / RDIMM / VLP / .....
- 技術與世代：  
CXL / DDR5 / DDR4 / DDR3 / DDR2



產業型邊緣 AI

On-device SSD

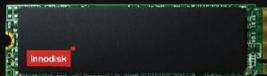
工控垂直應用市場



企業型邊緣 AI

On-prem edge AI SSD

企業私有 AI 伺服器  
(KV cache SSD)



企業型邊緣 AI

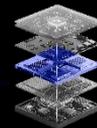
Central Cloud

AI 伺服器 (CSP)  
資料儲存



Inference

Training



## MAXIMIZING SYSTEM BOOT RELIABILITY

## 資料中心 SSD | 開機碟

SATA III and PCIe Gen 4 / U.2, M.2, 2.5", E1.S



- 優化啟動：高速啟動和高速作業系統載入
- 可靠性：高耐久性，可承受頻繁的資料寫入

## ACCELERATING LARGE-SCALE DATA THROUGHPUT

## 資料中心 SSD | 資料碟

PCIe Gen5 / U.2, EDSFF (E3.S, E3.L and E1.S)



- 高吞吐量：專為大規模資料處理設計，展現高效能與穩定性
- 低延遲：高擴展性，滿足繁重的資料處理和儲存需求

## Flash Storage (SSD) Portfolio

PCIe



SD



SATA



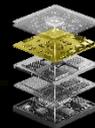
USB



PATA



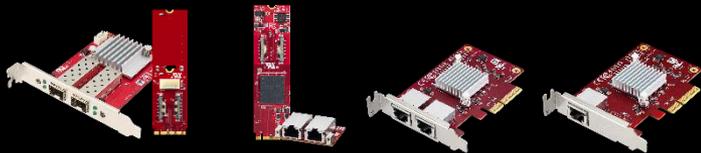
- 規格尺寸與技術：  
M.2 / U.2 / CFexpress / EDSFF / 2.5" / 1.8" / SATA Slim /  
SATADOM / mSATA / CFast / nanoSSD / CompactFlash Card /  
SD Card & MicroSD Card / USB / USB EDC



## REVOLUTIONIZING COMPACT SYSTEM BOOTING

### 高速網路擴充卡

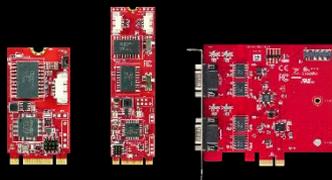
M.2 to Dual 10GbE SFP+ LAN Module  
M.2 2280 Dual 10GbE LAN Module



- 節省空間：全球首款適用於小型機殼的 M.2 SFP+ 網路模組
- 優化啟動：高速穩定的資料傳輸，顯著縮短啟動時間

## ENHANCING HIGH-EFFICIENCY DATA EXCHANGE

### CAN FD 系列



- 快速通訊：為複雜系統提供快速可靠的資料交換
- 卓越效能：更高的單一訊息傳輸資料量，效能顯著提升

## Intelligent Peripheral Solution Portfolio

LAN



CAN Bus & CAN FD



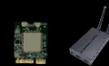
CAN + GNSS

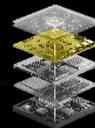


Serial



Wi-Fi





## RUGGEDIZED LONG-RANGE VISION &amp; CLARITY

## GMSL2 相機模組系列

高頻寬、長距離、低延遲

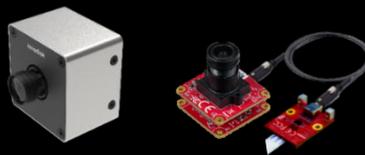


- IP67/IP69K 防護等級：最高等級的防水防塵
- 15 公尺超長傳輸距離：遠距離傳輸性能穩定
- 板載 ISP：卓越的影像品質和專業控制
- 支援 NVIDIA Jetson 和 RPi：相容於主流 AI 平台

## REDEFINING EDGE AI VISION STANDARDS

## MIPI OVER TYPE-C 相機模組

800萬畫素定焦相機模組



- 獲獎肯定：取得專利技術，並獲得台灣精品獎肯定
- MIPI 擴充：高速訊號，專為邊緣 AI 設計
- 板載ISP：整合晶片，實現卓越的影像控制
- 多平台相容：支援 NVIDIA Jetson、Intel 和 Raspberry Pi

## Camera Module Portfolio

USB 2.0



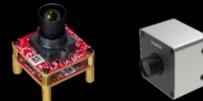
MIPI CSI-2



GMSL2



MIPI over Type-C



Capture Card





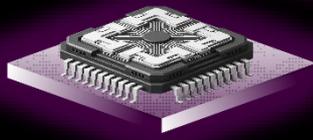
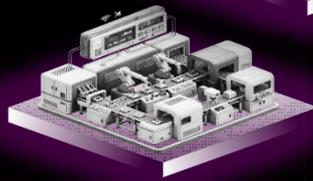
建構Agentic AI (代理式 AI)

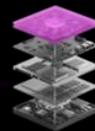
模型訓練與推論工具套件

API & SDK 開發套件

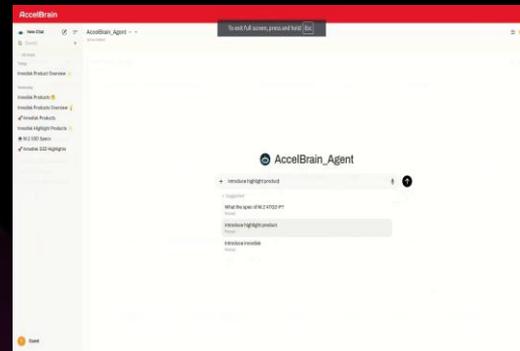
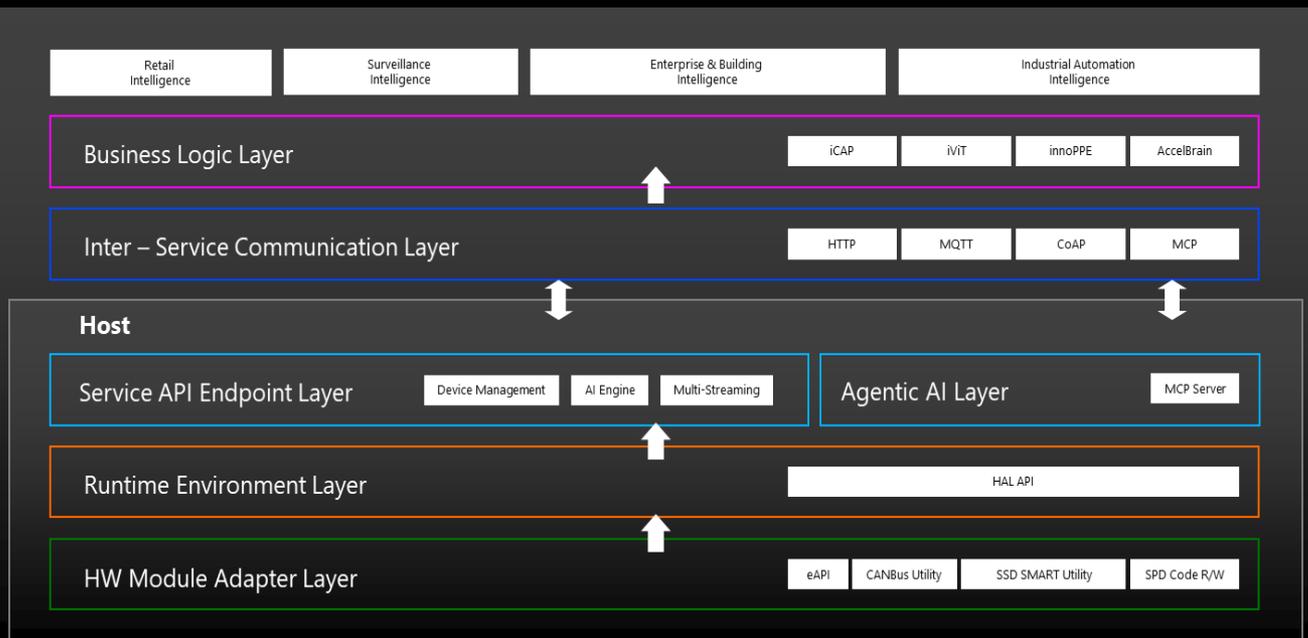
設備管理

OS / Driver 底層驅動

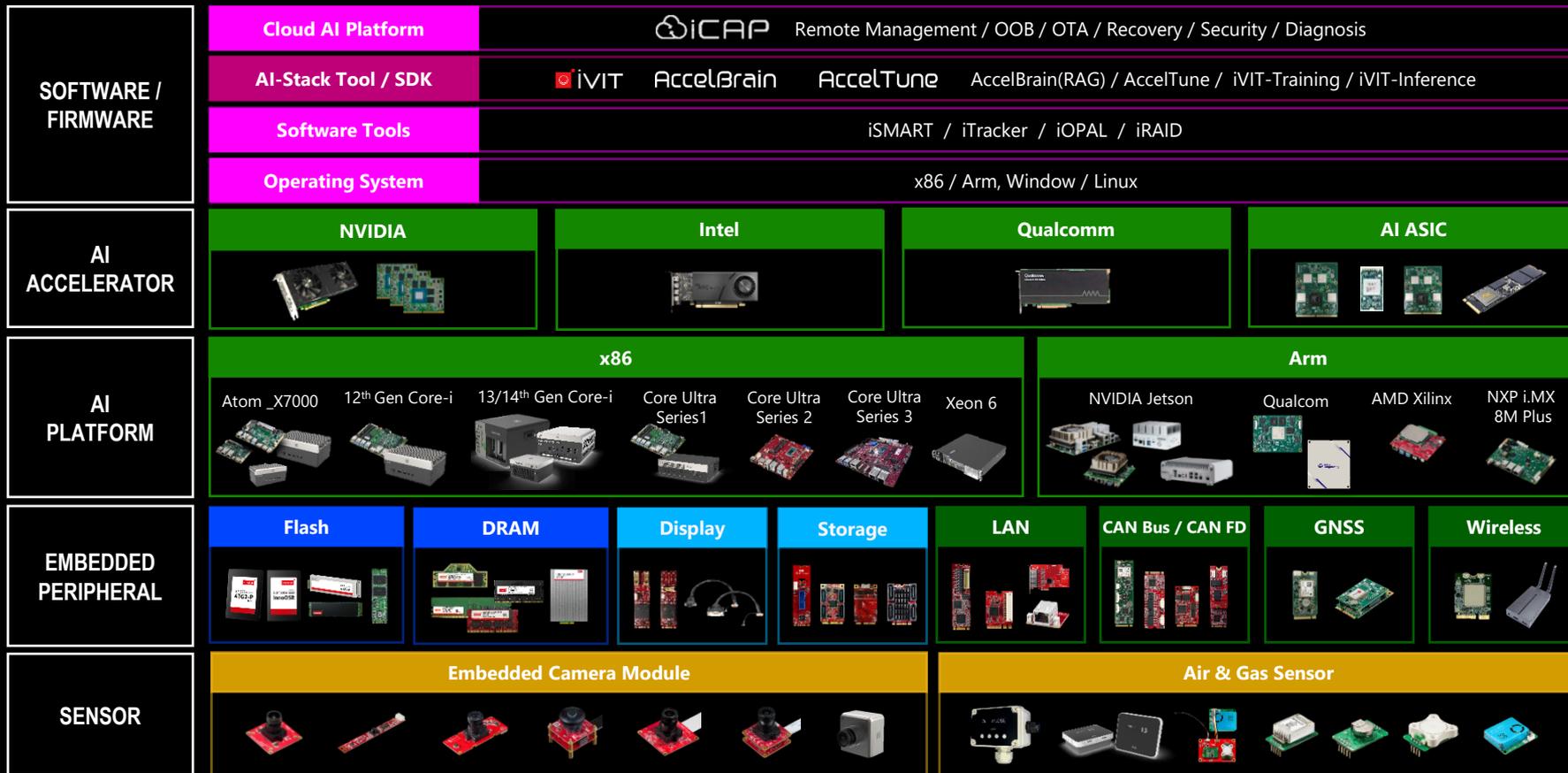




## 堅強軟體研發實力，創造邊緣 AI 附加價值



# INNODISK 邊緣 AI 解決方案架構 / INNODISK EDGE AI BUILDING BLOCKS



# 全球 AI IN ACTION 商務拓展

# EMBEDDED WORLD 2026

@德國 紐倫堡



# NVIDIA GTC 2026

@美國 聖荷西



# INNODISK AI IN ACTION

於全球積極拓展邊緣 AI 解決方案



Smart City Expo World Congress



Edge Tech+ @Japan



Smart Factory & Automation @Korea



ICE 2026 @Spain

# ESG 永續承諾

## 2025 永續亮點

- 公司治理評鑑名列 6 ~ 20% 等級
- 通過董事會核准淨零排放路徑目標，積極邁向淨零轉型的長程方向
- 成立「永續發展暨資安委員會」，強化公司在環境、社會、治理與資訊安全面向的整合管理與效率
- 榮獲國際 EcoVadis 銅級及天下永續公民獎、天下人才永續獎、親子天下友善家庭職場獎等多項殊榮，展現宜鼎在永續治理的全方位成果



@宜蘭縣 無尾港 生態復育 / 候鳥棲地保育 / 防風林植樹 / 社區創生共榮

## 2026 發展目標

- 持續推進再生能源提升與能源管理導入，實現減碳行動成效
- 推動員工參與及社會共融計畫，深耕生物多樣性計畫以擴大永續影響力
- 完善永續治理架構與資訊揭露，強化與國際標準IFRS接軌



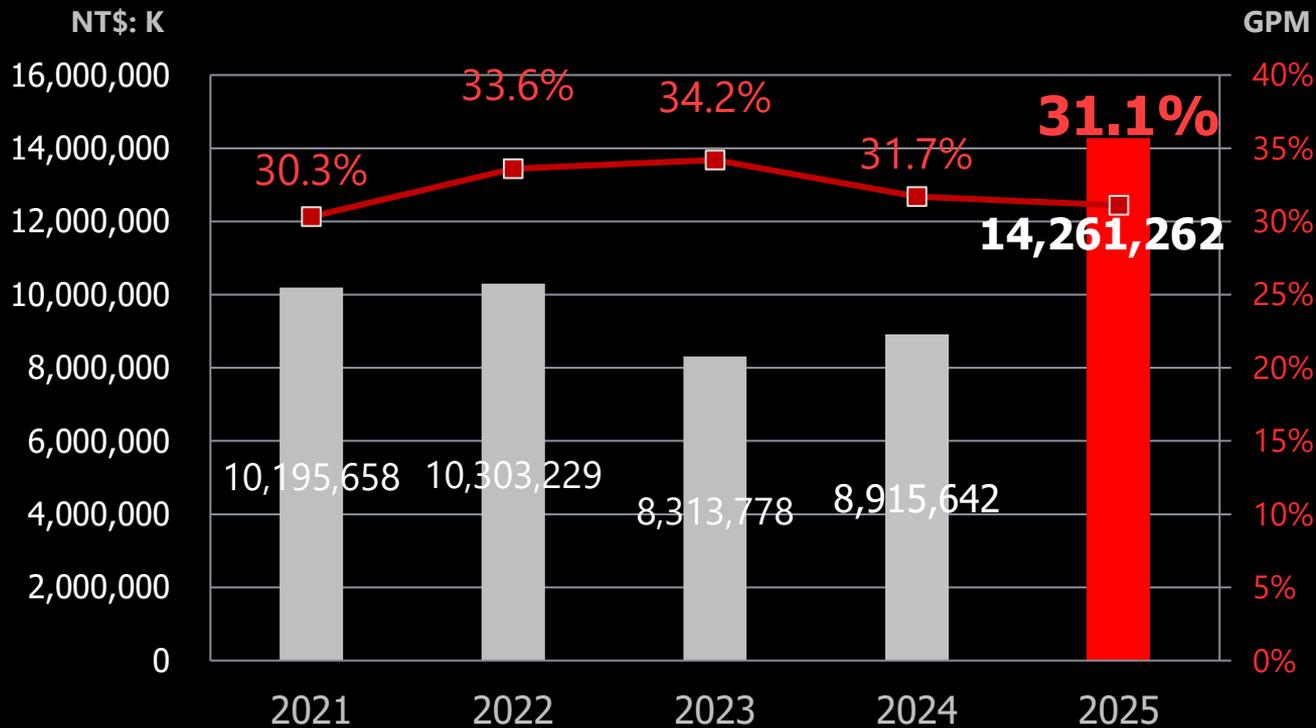
@新北市 翡翠灣 海洋保育 / 海洋教育 / 企業親子淨灘活動



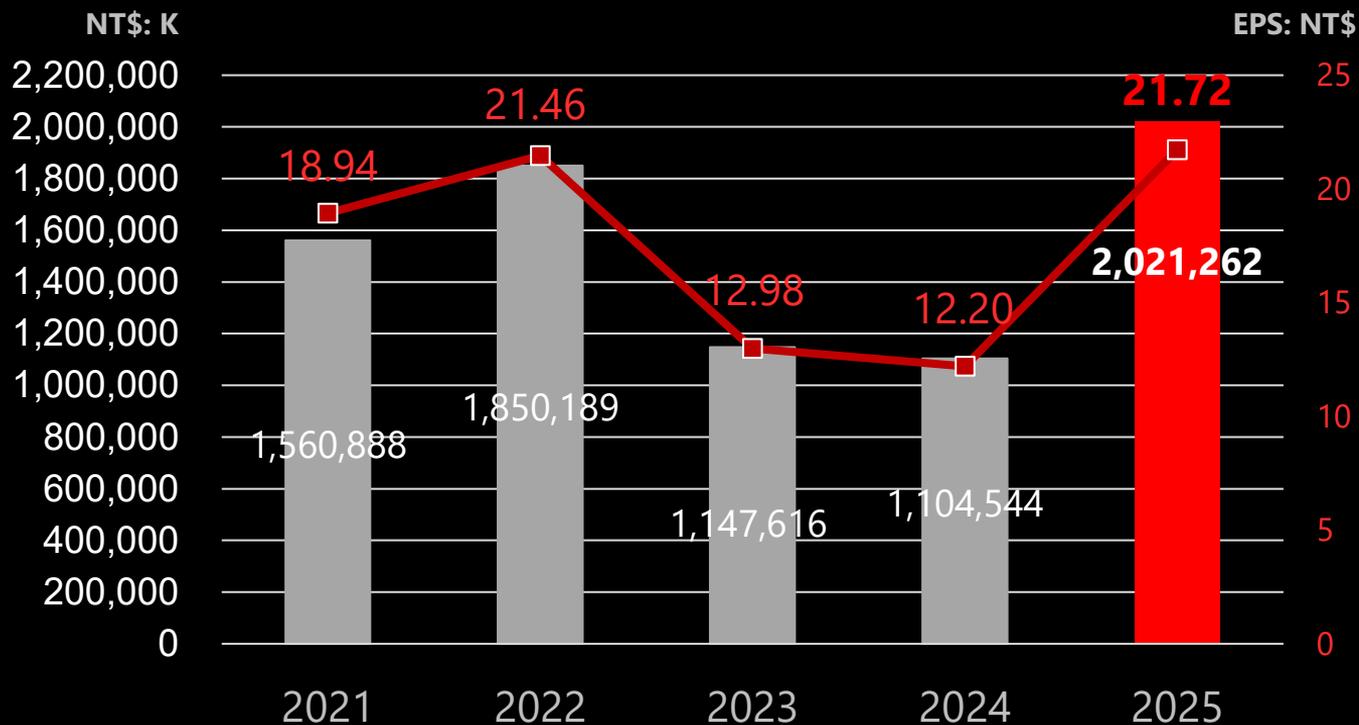
# 宜鼎國際 永續之路

# 財務資訊

## 過去 5 年營收與毛利率

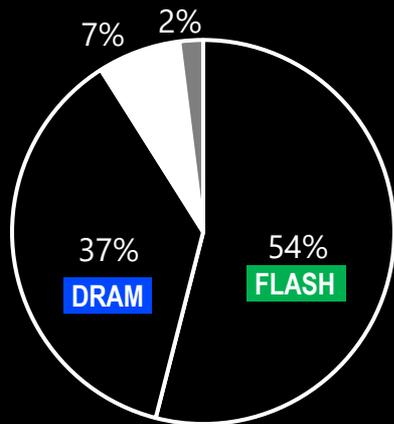


## 過去 5 年淨利與 EPS

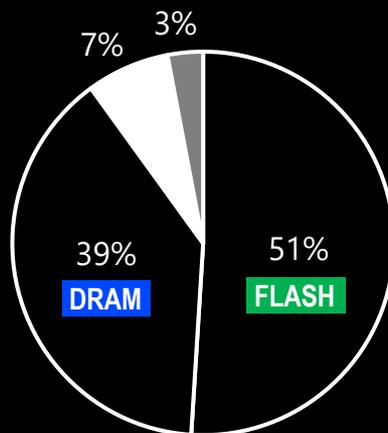


## 產品營收佔比變化

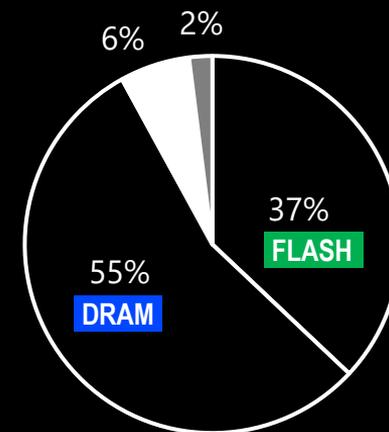
2023



2024



2025



□ DRAM

□ FLASH

□ AI Solutions

□ Others

## 營收依區佔比



## 過去3年損益表

	2023	2024	2025	YoY
營業收入	8,313,778	8,915,642	14,261,262	60.0%
營業成本	5,467,866	6,090,393	9,829,334	61.4%
營業毛利	2,845,912	2,825,249	4,431,928	56.9%
營業費用	1,465,884	1,646,753	2,042,500	24.0%
營業利益	1,380,028	1,178,496	2,389,428	102.8%
營業外收入及支出	51,060	170,643	67,884	-60.2%
稅前淨利	1,431,088	1,349,139	2,457,312	82.1%
所得稅費用	286,921	244,595	436,050	78.3%
本期淨利	1,144,167	1,104,544	2,021,262	83.0%
非控制權益利益	-3,449	-1,628	-14,381	
歸屬母公司淨利	1,147,616	1,106,172	2,035,643	84.0%
基本每股盈餘	12.98	12.20	21.72	
毛利率	34.2%	31.7%	31.1%	
營業利益率	16.6%	13.2%	16.8%	
淨利率	13.8%	12.4%	14.2%	

# 提問與說明

**innodisk**

**ARCHITECT  
INTELLIGENCE**